

半导体硅片异形切割晶圆精密钻孔微孔异形孔加工个性定制

产品名称	半导体硅片异形切割晶圆精密钻孔微孔异形孔加工个性定制
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:华诺激光 加工方式:激光切割加工 加工材质:半导体材料、硅片、晶圆
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

产品详情

半导体硅片异形切割晶圆精密钻孔微孔异形孔加工个性定制

华诺皮秒紫外激光切割机适用于半导体材料硅片、晶圆的切割打孔加工。相比传统机械的切割方式，通过皮秒紫外激光切割硅片可以将切割带来的影响减到*低，热影响也更小。加工精度也更高，边缘更为光滑。